

CUTTING EDGE

カッティングエッジ

79期中間事業のご報告

平成29年4月1日～平成29年9月30日

社長メッセージ



幅広い分野における「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」需要の拡大により 売上高・利益は過去最高を更新しました。

事業環境・業績

2017年度上期は、スマートフォンやデータセンタのサーバ向けに高性能な半導体の需要が高まったことから、フラッシュメモリを中心に積極的な設備投資が見られました。加えてディスクリットや電子部品など幅広い様々な分野における精密加工ニーズも高まり、切断装置・研削装置とともに前年同期に比べ出荷が大幅に増加しました。

こうした様々な加工ニーズの高まりは顧客の装置需要に加え設備稼働率の高さにも現れており、これらを背景に消耗品である精密加工ツールの出荷数量は非常に高い水準で推移しました。

損益については販売管理費の増加はあったものの、売上高の増加と付加価値の高い装置・消耗品への需要増による製品ミックスの改善により粗利益は増加しました。

これらの結果、上期業績は売上高・利益ともに過去

最高を更新しました。

中間配当金につきましては、配当方針に基づき業績連動により増配(1株当たり141円)とさせていただきます。

今後の見通し

今年度は引き続き、顧客においてメモリ等の幅広い分野での投資が継続されることにより売上高・当期純利益ともに5期連続で過去最高を更新する見込みです。

中長期視点では、IoT、自動運転技術や医療分野など、技術の進展を背景とした半導体・電子部品の需要増加が見込まれます。顧客の「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」へのニーズに対応するため、積極的な研究開発を進めてまいります。また生産体制の更なる強化が必要であると判断し、長野事業所の茅野工場の開設や、桑畑工場(広島県呉市)に現在建築中のCゾーンに加え、更にDゾーン(19年9月着工予定)を

増築することを決定しました。

株主還元については、現時点での業績予想をもとに上記の積極投資を行うための必要資金を確保すること等により、追加配当※の原資となる余剰資金が前年よりも減少する見込みであり、現時点において期末の配当につきましては、減配を予定しております。

今後も、良質な企業文化の醸成に注力するとともに、社員一人ひとりが能動的に動ける仕組みづくりや進化・改善活動を継続してまいります。

ステークホルダーの皆様におかれましては一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

※追加配当について

年度末に、赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額を超過した場合は、業績連動分に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乘せいたします。

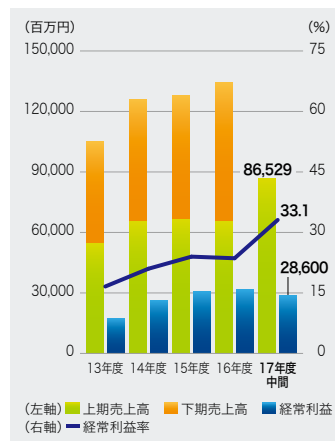
2017年12月

代表取締役社長 関家一馬

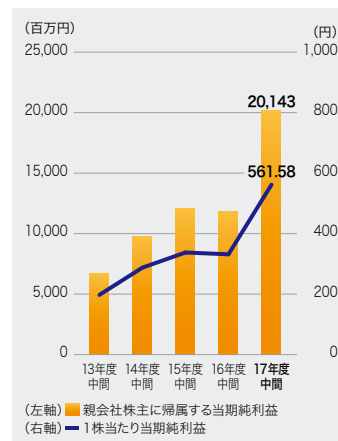


財務ハイライト

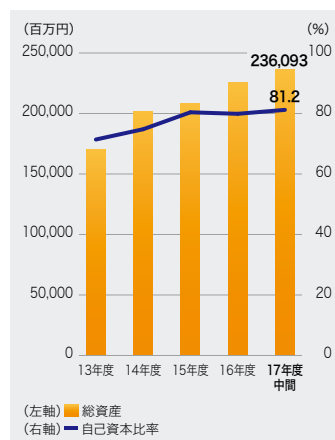
売上高・経常利益・経常利益率



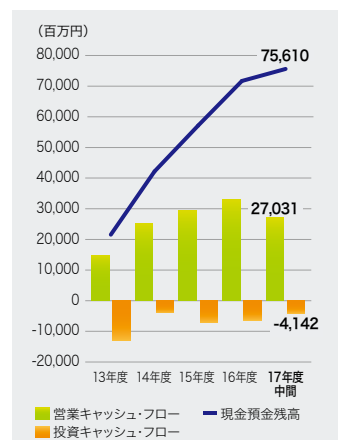
親会社株主に帰属する当期純利益・1株当たり当期純利益



総資産・自己資本比率



キャッシュ・フロー



当期の概況

当期(2017年4月1日から2017年9月30日)においては、アジアをはじめ日米欧の各地域でも、半導体メーカ各社は前年の水準を大きく上回る意欲的な設備投資を行いました。精密加工装置の売上高は、精密切断装置(ダイサ)と精密研削装置(グラインダ)ともにメモリ向けを中心に半導体、非半導体で幅広い用途で出荷が堅調に推移したことから、前年同期と比べ約5割増加しました。消耗品である精密加工ツールは、メーカ各社の設備稼働率に比例して高水準の出荷が続いており、その売上高は前年同期と比べ約2割増加しました。これらの結果、連結売上高は半期ベースで過去最高を更新しました。

損益としては、高付加価値製品の販売が伸長しGP率が上昇したことに加えて、人件費など販売管理費が増加したものの、売上高の大幅増加により販売管理費の比率が低下したため、営業利益は大幅な増益となりました。

以上の結果、当期の業績は売上高865億29百万円(前期比32.6%増)、営業利益288億99百万円(同94.1%増)、経常利益286億円(同83.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益20億43百万円(同69.8%増)となり、各利益は半期ベースで最高益を更新しました。

■財政状態

当期末の総資産は、前期末と比べ103億45百万円増加して2,360億93百万円となりました。これは、売上高の増加に伴い、主に売掛金や現預金が増加したことによるものです。

負債は、前期末と比べ10億57百万円減少して433億72百万円となりました。これは、未払法人税や仕入債務が増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金を返済したことによるものです。純資産は、前期末から114億3百万円

増加し1,927億21百万円となり、自己資本比率は前期末比1.3ポイント増の81.2%となりました。

■キャッシュ・フロー

営業活動では、270億31百万円の資金増加、投資活動では、41億42百万円の資金減少だったことから、フリー・キャッシュ・フローは、228億88百万円の資金増加となりました。これは、売上債権の増加や有形固定資産の取得による資金減少があったものの、税金等調整前四半期純利益が大きく増加したためです。財務活動では、主に配当金の支払いと長期借入金の返済によって192億71百万円の資金減少となりました。これらの結果、当期末の資金残高は、前期末から39億19百万円増加し、756億10百万円となりました。

通期の連結業績予想

フラッシュメモリ、高性能プロセッサ、電子部品向けなどの幅広い分野で高度なKiru・Kezuru・Migaku技術の需要が拡大しています。メーカ各社の設備投資や生産活動は活発で、設備稼働率も高水準で推移することが予想され、精密加工装置、精密加工ツールともに堅調な出荷が継続する見込みであることから、通期の売上高・各利益は、5期連続で過去最高を更新する見込みです。

2018年3月期

(金額の単位:百万円)

売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
158,300	45,600	45,900	32,700	911.51円



ディスコの企業理念



「高度な**Kiru・Kezuru・Migaku**技術によって
遠い科学を身近な快適につなぐ」

3つのコア技術を深めることで、ディスコは産業と暮らしに貢献していきます。

「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」とは

ディスコのビジネステーマを指しています。人類に欠かせない普遍的な技術である「切る」「削る」「磨く」という事業領域において、ディスコは世界のオンリーワン企業でありたいと考えています。あえてローマ字で表記しているのは、これらの分野でディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという、強い思いが込められているからです。

「遠い科学を身近な快適につなぐ」とは

ディスコの社会的使命(ミッション)を意味しています。日々進歩していく科学技術を、ディスコの「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」によって、人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたい、という考えを表現しています。

ディスコが追い求める成長とは

企業の成長をどのように定義するかによって、経営の方向性は大きく変わります。ディスコの「成長」とは売上やシェア、規模の拡大などに依らず、2つの基準によって評価されています。ひとつはミッションの実現度が高まり、社会により大きく貢献ができているか、もうひとつはお客様・従業員・サプライヤ・株主など、すべてのステークホルダとの価値交換性が向上しているか、です。